

レーザー封止用ガラスフリット

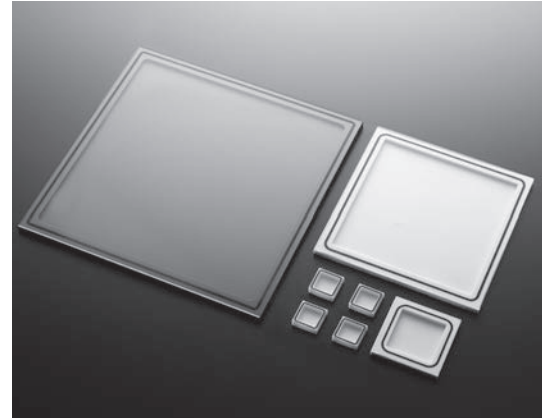
レーザー封止用ガラスフリットは、ガラス基板と異種材料*やガラス基板同士の気密封止を可能にします。

封止時の素子への熱ダメージを避け、高い信頼性が要求とされるデバイスに使用できます。

* 例:アルミナ、LTCC、シリコン

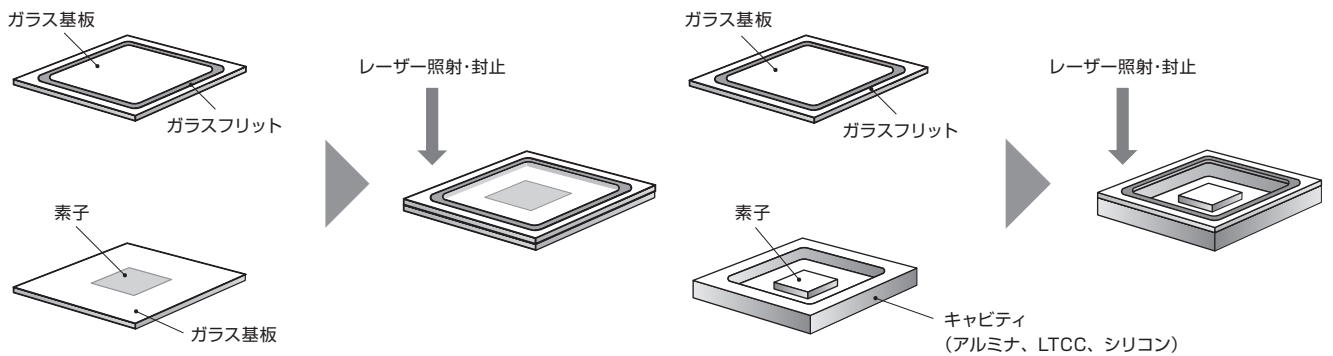
●特長

- 局所加熱封止により内部素子への熱ダメージ防止
- 高い気密信頼性
- フリット付きガラス基板での供給が可能
- レーザー封止の試作条件出しもサポート可能



使用例

●レーザーシールプロセス



●用途

- MEMSパッケージ
- 深紫外LEDパッケージ
- 気密封止パッケージ
- 有機ELデバイス
- ペロブスカイト型太陽電池

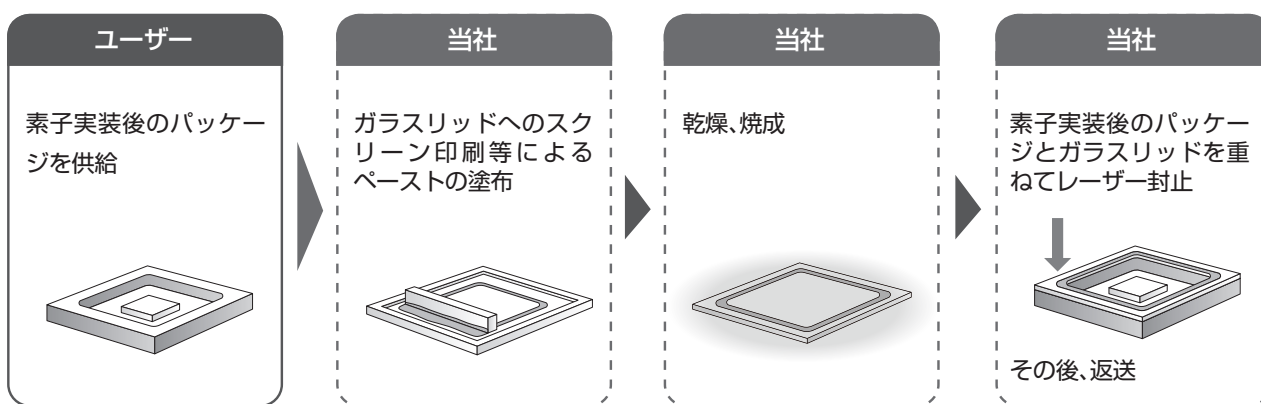
●対応可能なキャビティ材質とサイズ

キャビティ材質	パッケージ/基板サイズ	ガラスリッド厚
LTCC	～60mm	～1mm
アルミナ	～60mm	～0.5mm
ガラス	～200mm	～1mm
シリコン	～10mm	～0.2mm

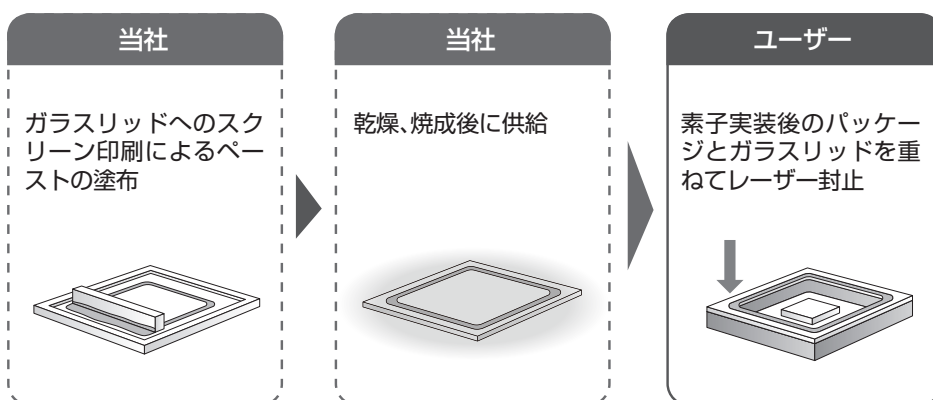
●試作工程

- 下記に示す形態での試作品供給に対応
- ユーザー側での工程簡略化が可能

1. 当社でレーザー封止した試作パッケージを提供



2. レーザーガラスフリットを塗布し焼結させたガラスリッドを供給
ユーザーにてレーザー封止を実施



- レーザーガラスフリットを焼結させたガラスリッドは、当社製のさまざまな熱膨張係数に対応したガラスリッドから選択することが可能です。